

国泰海通证券股份有限公司

关于芯联集成电路制造股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称“芯联集成”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会《关于同意绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]548号），并经上海证券交易所同意，绍兴中芯集成电路制造股份有限公司（以下简称“公司”或“芯联集成”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）169,200万股（行使超额配售选择权之前），并于2023年5月10日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行A股前总股本为507,600万股，首次公开发行A股后总股本为676,800万股（行使超额配售选择权之前）。公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票超额配售选择权已于2023年6月8日全额行使，对应新增发行股数25,380万股，由此公司总股本增加至702,180万股，其中有限售条件流通股5,981,223,727股，占公司发行后总股本的85.18%，无限售条件流通股1,040,576,273股，占公司发行后总股本的14.82%。

本次上市流通的限售股为首次公开发行战略配售限售股份，对应限售股股东1名，对应限售股份数量33,840,000股，占公司股本总数的0.48%，限售期为自公司股票上市之日起24个月。现限售期即将届满，因2025年5月10日为非交易日，故该部分限售股顺延至下一交易日2025年5月12日上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

（一）首次公开发行上市

2023年5月10日，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）169,200万股并在上海证券交易所科创板挂牌上市，本次发行完成后总股本为676,800万股，其中有限售条件流通股5,727,423,727股，无限售条件流通股1,040,576,273股。

2023年6月15日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司关于超额配售选择权实施结果的公告》（公告编号：2023-017）。公司于2023年6月8日全额行使超额配售选择权，因行使超额配售选择权而延期交付的25,380万股股票，已于2023年6月13日登记于参与战略配售的投资者的股票账户名下，自本次发行的股票上市交易日（2023年5月10日）起锁定24个月或12个月。公司的股本总额由676,800万股变更为702,180万股。

（二）股票期权激励计划行权

因公司实施《第一期股票期权激励计划》，公司股本在本次期权行权后因第一期股票期权激励计划的行权登记合计新增4,728.52万股，公司总股本由702,180万股变更为706,908.52万股，具体情况如下：

序号	股份变动日期	股份变动事项	股份变动数量（股）	公告索引
1	2023年9月7日	第一期股票期权激励计划第一个行权期第一次行权	20,767,475	《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司关于第一期股票期权激励计划第一个行权期第一次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-031）
2	2023年11月27日	第一期股票期权激励计划第一个行权期第二次行权	2,034,800	《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司关于第一期股票期权激励计划第一个行权期第二次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-038）
3	2024年2月5日	第一期股票期权激励计划第一个行权期第三次行权	1,144,875	《芯联集成电路制造股份有限公司关于第一期股票期权激励计划第一个行权期第三次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-010）
4	2024年5月7日	第一期股票期权激励计划第一个行权期第四次行权	893,850	《芯联集成电路制造股份有限公司关于第一期股票期权激励计划第一个行权期第四次行权结果暨股份变动的公告》（公告

				编号：2024-037)
5	2024年6月27日	第一期股票期权激励计划第二个行权期第一次行权	7,016,113	《芯联集成电路制造股份有限公司关于第一期股票期权激励计划第二个行权期第一次行权结果暨股份变动的公告》(公告编号：2024-050)
6	2024年11月26日	第一期股票期权激励计划第二个行权期第二次行权	5,429,900	《芯联集成电路制造股份有限公司关于第一期股票期权激励计划第二个行权期第二次行权结果暨股份变动的公告》(公告编号：2024-086)
7	2025年1月23日	第一期股票期权激励计划第二个行权期第三次行权	2,758,137	《芯联集成电路制造股份有限公司关于第一期股票期权激励计划第二个行权期第三次行权结果暨股份变动的公告》(公告编号：2025-002)
8	2025年3月20日	第一期股票期权激励计划第二个行权期第四次行权	7,240,050	《芯联集成电路制造股份有限公司关于第一期股票期权激励计划第二个行权期第四次行权结果暨股份变动的公告》(公告编号：2025-007)
合计			47,285,200	-

除上述股本变化外，本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东关于其持有的股份锁定和减持的有关承诺情况如下：

“海通创新证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。”

除上述承诺外，本次申请上市流通的战略配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为33,840,000股，占目前公司总股本的0.48%，限售期为自公司股票上市之日起24个月。公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

（二）本次上市流通日期为2025年5月12日。

（三）限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	海通创新证券投资有限公司	33,840,000	0.48	33,840,000	0
合计		33,840,000	0.48	33,840,000	0

注：持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留两位小数，总数与各分项数值之和尾数不符的情形，为四舍五入原因造成；

限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	战略配售限售股	33,840,000	24
合计		33,840,000	-

五、保荐机构核查意见

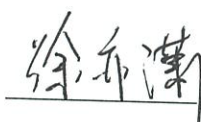
经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，公司上述限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。本次限售股份上市流通符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求。公司对本次网下配售限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，国泰海通对公司本次限售股份解限上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于芯联集成电路制造股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：


徐亦潇


宋轩宇



国泰海通证券股份有限公司

2025 年 4 月 25 日